

合規科技資訊平台

提供內容備註

金管局歡迎合規科技界提供內容(包括研究報告、用例及活動等)。如有意向「合規科技資訊平台」提供內容，請以電郵方式寄交 regtech@hkma.gov.hk。

提供內容時，請載明以下各項資料(下稱「相關資料」)：

- 作者資料：作者全名
- 刊物資料：出版商名稱(如與作者不同)及出版日期
- 內容描述：刊物主題及其與合規科技的相關性
- 刊物類別：合規科技新聞/合規科技發展/合規科技活動/合規科技相關連結
- 提供者資料：全名、聯絡方式(包括電郵及電話號碼)、職銜及所屬機構

請只提供由閣下/貴機構作為其知識產權(包括但不限於版權)擁有人的內容。請注意，金管局不能保證閣下/貴機構提供的內容會被刊載。

如閣下/貴機構(下稱「提供者」)向金管局提供內容，即表示提供者承認已細閱以下條款及條件，並且提供者會被當作已無條件接受及同意受以下條款及條件約束。如提供者不同意以下條款及條件，則請勿向金管局提供任何內容。

1. 提供者承認及明白，提供者提供的訊息、文件、材料及 / 或報告(統稱「內容」)及相關資料可能會(全部或局部)在「合規科技資訊平台」發布。提供者進一步承認及明白，發布內容或其任何部分的決定，純屬香港金融管理局(下稱「金管局」)所有。金管局保留權利刪除在「合規科技資訊平台」所發布的任何內容。
2. 提供者向金管局陳述及保證 (a) 相關資料真實及準確；(b) 提供者是內容的知識產權(包括但不限於版權)的擁有人；(c) 提供內容並不侵犯任何人的任何知識產權(包括但不限於版權)及其他權利，亦不違反任何保密責任(無論因法律、協議或其他原因所產生)，並且遵守適用法律；及 (d) 金

管局就本條款及條件所擬定的目的來使用內容或其任何部分(包括但不限於保留、編輯、改編及複製內容)並不或不會侵犯任何人的任何知識產權(包括但不限於版權)及任何其他權利，亦不會違反任何保密責任(無論因法律、協議或其他原因所產生)。對於金管局可能因提供者失實陳述或因內容侵犯任何第三方權利而所招致的所有申索、損失、損害、費用、支出或責任(無論直接或間接)，提供者須在金管局提出要求時向金管局作出十足的彌償並使金管局免受損失。

3. 提供者授予金管局為在「合規科技資訊平台」發布及其他相關與附帶目的使用內容或其任何部分(包括但不限於保留、編輯、改編及複製內容)的權利。提供者同意金管局在「合規科技資訊平台」發布內容或其任何部分前無需提供者給予同意，並且金管局無需向提供者支付任何收費或費用。
4. 本條款及條件的英文版與本條款及條件的中文版如有差異，以英文版為準。
5. 本條款及條件受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管轄，並須按照該等法律詮釋；提供者同意接受香港法院的專屬司法管轄。
6. 如閣下代表某實體提供內容，則閣下陳述及保證閣下有權代表該實體無條件接受本條款及條件，並使該實體受本條款及條件約束(在本條款中，凡提述「提供者」均指該實體)。

個人資料收集聲明

金管局在提供者提供內容時向其收集的個人資料將會用作與「合規科技資訊平台」的運作相關的用途，包括任何必要的行政管理工作、跟進聯絡、統計及服務監察，以及金管局的[私隱政策聲明](#)下的相關目的。除非法律允許或有規定，否則個人資料不會未經閣下同意被用作任何其他用途，亦不會予以披露或轉移。

提供個人資料屬自願性質。如未能提供所要求的個人資料，或所提供資料不正確或不完整，金管局或未能考慮或處理閣下提供的內容。

閣下有權要求查閱及更正本局持有的閣下的個人資料。如閣下希望行使這項權利，請以電郵 (publicenquiry@hkma.gov.hk) 聯絡本局的「個人資料私隱主任」。